

1. スリップリング間の導通点検

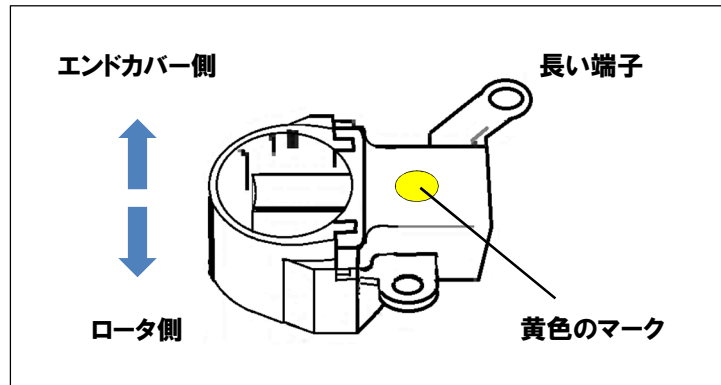
・基準値:導通があること

2. スリップリングとロータコア間の絶縁点検

・基準値:10MΩ以上

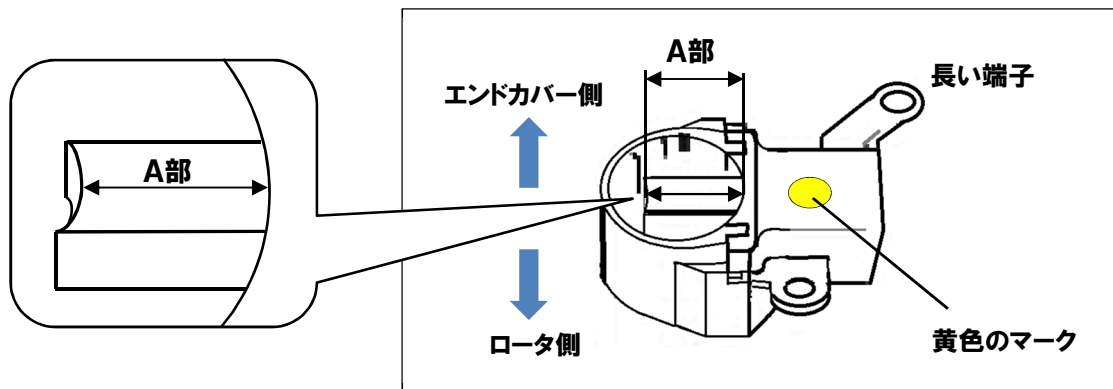
3. ブラシホルダ

(1) 黄色のマークがある方がエンドカバー側となる



(2) ブラシ長さ (ブラシホルダからの突き出し量 : A 部) の限度値

・限度値:4.5mm



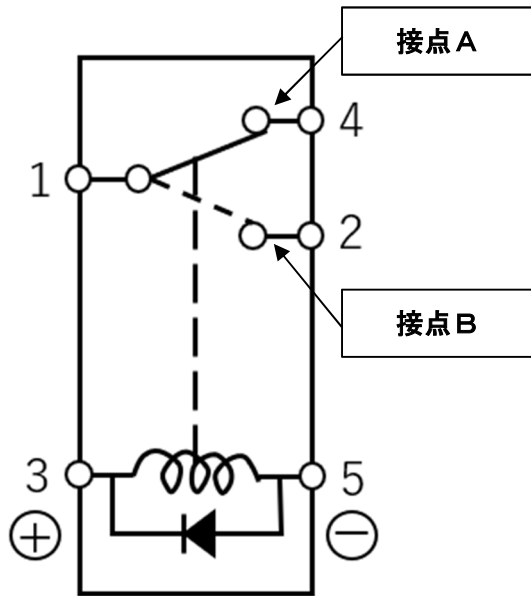
4. 測定位置について指示がない場合は、任意の1個所測定すれば良いこととする。

5. 点検時に、サーキット・テスタのブザー機能を使用しないこと。

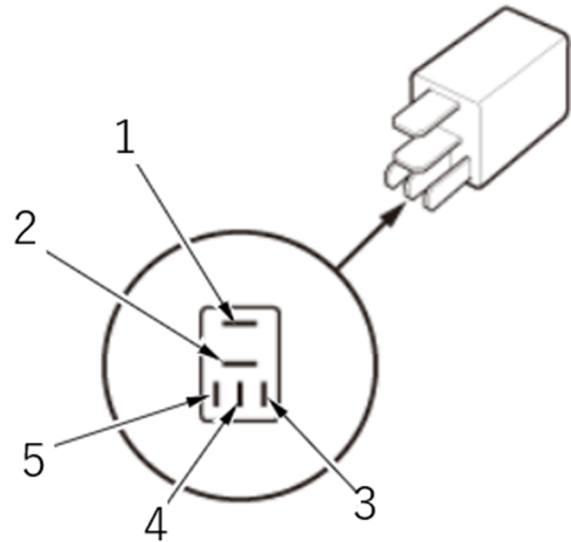
6. 点検開始前に、どの問の測定個所の点検を行うか採点員に申告し、了解を得てから点検を開始すること。

1. リレーの回路図及び端子配列は、下図のとおりである。

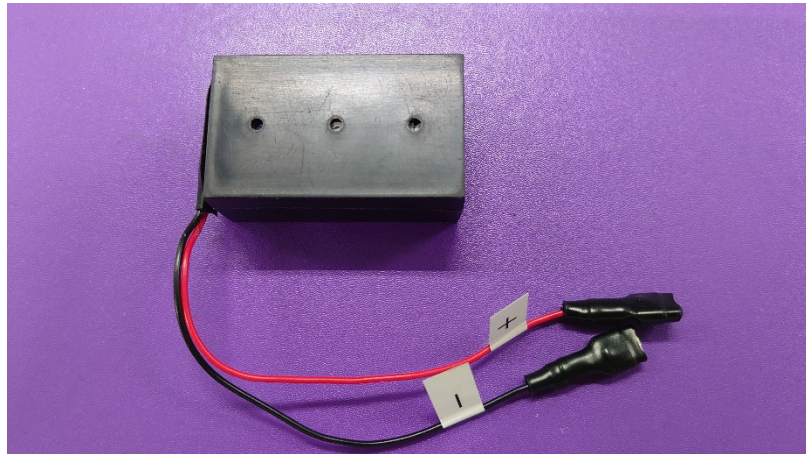
(回路図：非通電状態)



(端子配列)

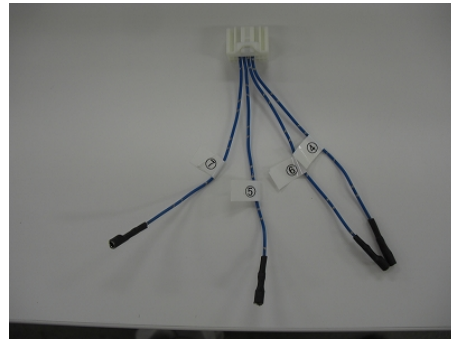


2. 各端子間の抵抗値の測定には、バッテリーを使用すること。(下図参照)




3. バッテリ電圧を逆に与えるとリレーのダイオードを損傷することがあるため、バッテリーの接続に注意して点検すること。
4. 点検時に、サーキット・テスタのブザー機能を使用しないこと。
5. 受験者は点検開始前に、バッテリーの接続状態を採点員に見せ、どの問の測定個所の点検を行うか採点員に申告し、了解を得てから点検を開始すること。

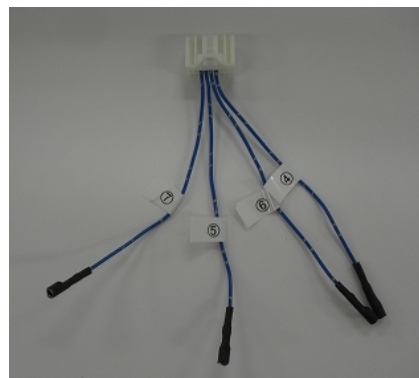
1. 各端子間の導通点検には、点検用ハーネスを使用して点検すること。



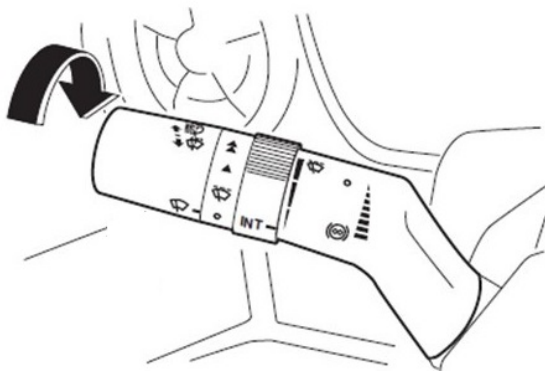
2. ワイパ・スイッチ各ポジションの端子間導通は、下表のとおりである。なお、配線番号は点検用ハーネスの配線番号に対応している。

※ ○—○ のみ導通がある
ワイパ・スイッチ

配線番号	4	5	6	7
ポジション				
OFF ○	○			
INT 	○—○			
LO ▲	○—○			
HI ▲▲	○—○—○			



3. ワイパ・スイッチの操作は、下図のとおりである。



- : OFF (停止)
-  : INT (間欠作動)
- ▲ : LO (低速作動)
- ▲▲ : HI (高速作動)

4. 点検時にサーキット・テスタのブザー機能は使用しないこと。
5. 点検開始前に、どの問の測定個所の点検を行うか採点員に申告し、了解を得てから点検を開始すること。
(申告例：ワイパLOを点検します。等)